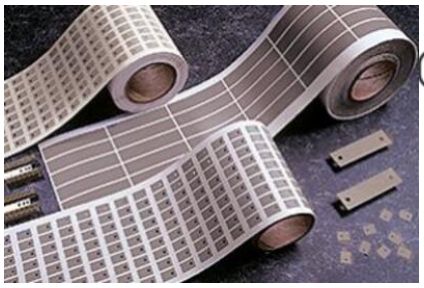
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIL PAD TSP 1100ST

Sil-Pad®1100ST

SIL PAD TSP 1100ST
Low-pressure, Fiberglass-reinforced, Silicone-based Insulator



- Sisäänrakennettu tarttuvuus molemmilla puolilla poikkeuksellisen lämmönsiirron ja helpon asennuksen takaamiseksi
- Uudelleen sijoitettavissa paremman käyttöasteen, käytön helppouden ja kokoonpanovirheiden vähentämisen vuoksi
- Varustettu pinnoitteella molemmilla puolilla helppoa käsittelyä varten ennen asennusta suurissa kokoonpanoissa
- Tarjoaa poikkeuksellisen lämmönsiirron suorituskyvyn jopa matalalla asennuspaineella
- Lasikuituvahvisteinen ja vaihtoehtoinen valinta Sil-Pad 1500ST:lle

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP 1100ST on lasikuituvahvisteinen lämpöliitäntämateriaali, jossa on sisäänrakennettu tarttuvuus molemmilla puolilla. Materiaali tarjoaa erinomaisen lämmönsiirron suorituskyvyn matalalla asennuspaineella.

Materiaali toimitetaan kahdella suojapaperilla, mikä helpottaa sen käsittelyä ennen automaattista asennusta suurissa kokoonpanoissa. Materiaali soveltuu erinomaisesti elektronisen teholaitteen ja sen lämmönpoistimen väliin sijoittamiseen.